

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于签署股权转让协议的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2026年3月27日，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于签署<股权转让协议>的议案》，即公司在取得光彩芯辰（浙江）科技有限公司（以下简称“标的公司”）20%股权的基础上，拟进一步增加对标的公司的投资，并拟与标的公司股东金帝联合控股集团有限公司（以下简称“金帝集团”）签署《金帝联合控股集团有限公司与苏州市世嘉科技股份有限公司关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），即金帝集团拟将其持有的标的公司5,291,005.55元注册资本（占标的公司总股本比例为6.9365%）以13,000万元的价格转让给本公司（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2026年3月28日在指定信息披露媒体上披露的《关于签署股权转让协议的公告》（公告编号：2025-015）。

二、交易进展情况

近日，标的公司已召开股东会审议本次交易相关事项。金帝集团将其持有的标的公司6.9365%股权转让予本公司，该事项已获得标的公司代表三分之二以上表决权的股东审议通过。根据《股权转让协议》约定，本公司已向金帝集团支付了股权转让总价款的50%，即6,500万元。本次交易的剩余对价将按照股权转让协议约定进行支付。本次交易的资金来源于公司自有资金或者自筹资金。

后续，公司将根据本次交易进展情况，按照有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露义务，并在公司指定信息披露媒体上刊登。

三、备查文件

1. 《光彩芯辰（浙江）科技有限公司股东会表决情况记录》；
2. 《银行回单》。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十六日